

证券代码：002213

证券简称：大为股份

深圳市大为创新科技股份有限公司
2026 年度以简易程序向特定对象
发行股票募集资金使用
可行性分析报告



二〇二六年三月

一、本次募集资金使用计划

本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过 10,850.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	嵌入式存储器研发和产业化项目	15,241.85	10,850.00

若公司在本次以简易程序向特定对象发行股份募集资金到位之前，根据公司经营况况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在募集资金到位后以募集资金予以置换。若实际募集资金数额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，对上述项目的募集资金投入金额进行适当调整。

二、本次募集资金投资项目的基本情况及可行性分析

（一）项目概况

本项目为嵌入式存储器研发和产业化项目，在公司现有技术及产品基础上，丰富产品结构，深化嵌入式存储业务布局。公司拟购置一系列生产检测、研发测试软硬件设备等，同时招聘专业技术人才，扩充研发团队，持续强化嵌入式存储领域的研发与业务能力建设。项目将助力公司进一步提升自主创新能力，加速在智能电视、网络通讯、平板电脑、商用显示等领域的业务拓展，提升公司的市场竞争力。

本项目计划投资总额 15,241.85 万元，拟投入募集资金 10,850.00 万元，其余部分由公司自筹解决，计划项目建设期为 3 年。

（二）项目实施的必要性

1、顺应行业发展趋势，把握市场增长机遇

当前，全球存储行业已步入新一轮增长周期。在智能化与数字化转型持续深化的背景下，下游应用场景对高性能、高可靠性存储产品的需求呈现稳步增长态势。公司经过不断发展，在产品认证领域和行业准入方面取得一定进展，获得多家行业客户的验证认可，为业务发展奠定了基础。近年来，公司紧密跟踪行业技术演进与市场趋势，积极布局产品升级和业务规模扩张，将提升自主品牌产品供给能力作为现阶段发展的重要战略方向。

通过本项目的实施，公司可依托现有管理体系与市场资源，强化 eMMC、DDR、LPDDR 等产品的市场供给能力，有效丰富产品结构，更好的满足客户应用需求，强化品牌影响力与服务能力，充分把握行业增长的机遇。

2、引进研发设备和优质人才，增强公司研发实力

随着下游应用场景持续演进与终端产品性能不断提升，市场对存储产品的容量、速度、功耗等关键指标提出了更为严格的要求，强化研发能力已成为企业构筑核心壁垒的关键支撑。在产业链自主可控趋势加速的背景下，国内存储器企业正积极通过技术迭代、产品升级与品牌建设，塑造差异化竞争优势。

近年来，公司业务规模不断增长，客户资源逐步积累。面对行业技术快速迭代的变化，公司急需系统性提升技术研发实力，加速构建具有自主知识产权的技术体系和品牌影响力，助力公司实现可持续发展。通过本项目的实施，公司将引进一系列先进研发设备，提升研发实力，同时公司将重点引进固件工程师、硬件工程师、产品测试工程师等关键领域技术人才，构建多层次、高素质的研发团队，有效提升研发效率与技术突破能力，逐步增强公司研发实力与自主品牌影响力。

3、增强测试能力，提升产品交付质量与效率

随着市场对存储产品的性能要求持续升级，对研发测试、生产测试的精准度、高效性提出了更高要求。为更好地匹配市场发展节奏，进一步强化产品竞争力、保障产品交付时效，公司计划系统性提升研发及生产测试能力，推动研发与生产测试能力更匹配市场需求，为业务持续发展提供坚实的支撑。

通过项目的实施，公司将构建高效且精准的测试体系。公司通过制定测试方

案，购置研发测试设备，实现固件研发定型和自主测试，并自主完成部分产品的量产测试，在现有测试能力的基础上提升效率和精度，重点强化存储产品系统测试能力，提高存储产品的兼容性与可靠性，进一步优化存储产品的性能。公司完善测试体系后能够有效提升产品交付的质量稳定性和时效准确性，为客户提供更可靠的交付保障，持续输出高质量产品和服务，巩固与客户的合作关系。此外，公司还将通过高效、精准的测试环节发现产品潜在问题，进一步为公司产品迭代升级和技术研发提供改进方向，为公司扩张业务规模提供良好技术支撑。

（三）项目实施的可行性

1、国家产业政策支持提供良好实施环境

半导体存储器作为数据存储、传输与处理的核心硬件载体，是集成电路产业的关键细分领域，更是支撑新一代信息技术产业高质量发展的重要基石，其技术的自主可控、供应的稳定可靠以及数据存储的安全性，关乎国家关键基础设施的运行、产业供应链的安全乃至核心信息的安全，是保障数字经济持续健康发展的重要前提。

近年来，我国持续完善产业政策体系，为半导体存储产业向“自主创新”转型提供了明确指引和制度保障。2024年12月，国家发改委等部门发布《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》提出，要加强新型存储技术研发，加快发展高带宽、大容量、高性能存储器；2025年8月，工信部等印发《电子信息制造业2025—2026年稳增长行动方案》，持续支持“集成电路”等领域科技创新，支持“先进存储”等前沿技术方向基础研究，坚定不移推动“国货国用”，加大对产业链关键企业的政策支持，强化关键核心技术攻关，提升重点产业链供应链韧性和安全水平。

国家通过多层次、全方位的政策体系，持续加大对半导体存储行业的支持力度，为本项目在技术研发、产业协同和市场拓展等方面营造了良好的外部环境。

2、下游市场广阔的发展机遇为产能消化提供重要支撑

当前，国际存储原厂将产能优先分配给HBM等高端产品线，这直接挤压了通用产品线的产能空间，供给的急剧收缩导致成熟存储领域出现结构性供给紧张。

与此同时，智能电视、网络通讯、平板电脑、商用显示等下游应用市场对存储产品的容量、速度、稳定性及低功耗特性提出更高要求，直接推动高性能成熟存储产品需求的增长。下游市场的稳定增长和行业面临的结构性机遇，为本项目的新增产能消化提供有利的市场条件，为项目的顺利实施提供重要支撑。

3、公司技术和人才储备奠定项目实施基础

公司经过多年的发展，客户资源逐步积累，销售规模稳步增长。公司的 DDR 及 LPDDR 产品保持稳定销售，部分产品已进入国内运营商供应体系，出货量增长相对稳定；同时，公司持续优化产品线，稳步交付 32GB、64GB 的 eMMC 产品，进一步完善嵌入式存储产品的布局。此外，为响应客户需求、紧跟技术趋势，公司积极推进现有存储产品升级迭代，推动高性能大容量 eMMC 产品的研发工作，为后续业务持续拓展筑牢基础。

人才团队方面，公司高度重视人才队伍的培养和赋能，逐步积累了资深的研发技术团队。核心成员深耕存储行业多年，对产业技术演进与市场需求具有前瞻性洞察。团队不仅掌握存储器结构设计、信号完整性、低功耗优化等关键技术，更具备将芯片、固件、封装、测试等多环节高效集成的系统级解决方案的能力，可快速响应客户定制化需求。在设计端，团队具备存储器产品的结构间协同设计能力；在测试端，团队自主研发系统级测试（SLT）平台，兼具存储晶圆介质标准与客户场景适应性。公司的核心团队为本项目实施以及后续公司产品在研发设计、运营管理等关键环节提供技术支撑和人才保障，为公司后续开拓市场与提升产品市场竞争力筑牢技术基础。

4、公司拥有完善的供应链体系和客户储备，为项目实施提供有力保障

经过多年行业深耕与核心资源沉淀，公司已构建起覆盖全业务链条的成熟运营体系，为嵌入式存储器业务稳定发展筑牢根基。在上游供应链领域，针对半导体存储产品中的存储介质晶圆、主控芯片及辅助材料等核心原材料，公司搭建了多层次采购体系，并制定标准化供应商管理规范。公司目前已与三星、SK 海力士等国际存储厂商供应链建立了良好的合作关系，同时加强了国产厂商长江存储、长鑫存储的方案布局，在利基市场加速国产替代，保障产能稳定。在封装测试环节，公司与行业领先的封装、测试厂商深度协同，通过全流程质量管控，确保产

品良率与性能可靠性。

在市场拓展方面，公司成效显著且布局清晰。依托良好的产品质量与优质的服务体系，公司成功导入四川九洲、广东朝歌、超越科技、康佳等重点行业客户，实现智能电视、网络通讯、平板电脑、商用显示等领域的突破。此外，公司持续整合存储资源，深化业务布局，产品已应用于移动运营商终端产品，市场影响力逐步提升。

通过本项目实施，公司可依托现有供应链体系与客户基础，进一步扩大嵌入式存储产品产能规模，丰富产品结构。同时，公司将强化与合作，加速存储解决方案的落地应用，提升公司市场响应能力与产品竞争力，为本项目的实施提供有力支持。

（四）募投项目业务模式

本次募投项目业务模式为自主品牌业务模式。自主品牌业务模式下，公司半导体存储器业务以存储产品方案设计和产品销售为主，封装贴片等产品制造环节采取委外加工模式，即根据客户需求及应用场景进行产品方案设计，方案设计内容主要包括基板电路设计、固件研发、主控芯片与存储芯片及其他辅助元器件的合理选型搭配、产品外观设计、产品封装测试方案设计等。确定产品方案后，公司向上游采购晶圆或存储芯片、主控芯片以及辅材，委托封装、贴片厂商进行加工制造形成产品，并根据公司制定的测试方案进行产品测试，测试完成后向客户销售。

通过本次募投项目实施，公司将重点扩大自主品牌的业务收入，持续优化半导体存储产品方案设计服务，增强公司核心竞争力，契合公司长期发展战略。

（五）项目投资概况及拟使用募集资金情况

本项目投资总额为人民币 15,241.85 万元，拟使用募集资金金额 10,850.00 万元，具体投资安排如下：

单位：万元

序号	项目	投资金额	拟使用募集资金金额	是否属于非资本性支出	占募集资金金额比例
1	建设投资	12,195.77	10,850.00		100.00%
1.1	场地投入	800.76	800.00	否	7.37%
1.2	软硬件投资	11,039.80	10,050.00	否	92.63%
1.3	预备费	355.21	-	是	-
2	研发费用	1,629.17	-	是	-
3	铺底流动资金	1,416.91	-	是	-
项目总投资		15,241.85	10,850.00		100.00%

由上表可知，本次募集资金均为资本性支出。

（六）项目实施主体及实施地点

本项目实施主体为深圳市大为创芯微电子科技有限公司和上海大为捷敏技术有限公司，均为公司全资子公司。

深圳市大为创芯微电子科技有限公司以公司自有房产广东省深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观盛五路8号大为股份科技园为项目的实施场所，上海大为捷敏技术有限公司以其租赁的上海市徐汇区虹梅路1801号A区凯科国际大厦为项目的实施场所。

（七）项目实施进度安排

本项目的建设期为3年。

（八）项目经济效益

本项目预计内部收益率13.83%（税后），预计静态投资回收期为7.97年（含建设期），具有良好的项目经济效益。

上述测算不构成公司的盈利预测，测算结果不等同对公司未来业绩做出保证，投资者不应据此进行投资决策，请投资者予以关注。

（九）项目审批、备案情况

截至本报告公告日，本项目已完成发改备案手续，已取得上海市徐汇区发展和改革委员会出具的《上海市企业投资项目备案证明》（项目代码：上海代码：310104MAEWGQ29620261D3101001，国家代码：2603-310104-04-05-780241）、深圳市龙华区发展和改革局出具的《深圳市企业投资项目备案证》（深龙华发改备案[2026]196号）。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，本项目不需要办理项目环境影响评价手续。

三、本次发行对公司财务状况、盈利能力及现金流量的影响

（一）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行募集资金到位、募投项目顺利实施后，公司合并报表的总资产及净资产规模均相应增加，资金实力将有所提升；有利于公司扩大业务规模，促进公司可持续发展。

（二）本次发行对公司盈利能力的影响

本次发行募集资金到位后，公司总股本和净资产均将有所增加，由于募集资金投资项目无法在短期内产生经济效益，每股收益和净资产收益率等财务指标在短期内可能出现一定幅度的下降。但从长期来看，募集资金投资项目有助于提升公司自主品牌业务的核心竞争力，促进公司半导体存储器业务高质量发展。

（三）本次发行对公司现金流量的影响

本次发行完成后，公司筹资活动现金流入将会有所增加。

四、本次募集资金使用可行性分析结论

综上所述，本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用符合相关政策

和法律法规,符合公司的现实情况和战略需求,有利于增强公司产品市场竞争力,扩大公司业务规模,提升公司行业地位,符合全体股东的根本利益。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会

2026年3月10日